

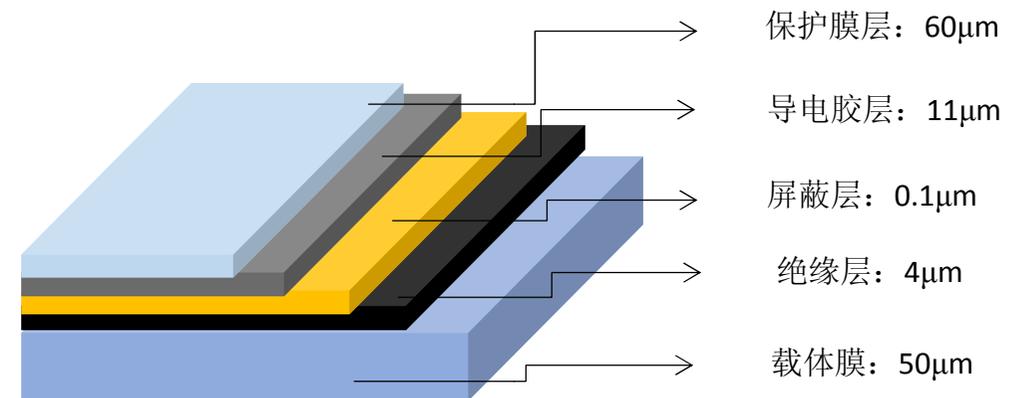
HCF-6000G-3D 技术规格书

◆ 产品规格

结构层	载体膜	绝缘层	屏蔽层	导电胶层	保护膜
材质	PET	绝缘油墨	金属合金	环氧树脂	聚脂膜
厚度(μm)	50	4	0.1	11	60

◆ 产品特点

- 1>具有优异的屏蔽效能
- 2>可实现阻抗控制、优良的接地性能
- 3>使用操作简便、效率高
- 4>耐高温性能测试
- 5>符合环保要求（无卤素、ROHS2.0、REACH 175）
- 6>不含有溴系，氯系和磷系阻燃剂
- 7>表面附着力优（达因值可达 34Dn 以上）





◆ 产品特性

项目	测试标准	测试结果	结果判定
接地电阻 (1.0 直径 SMT 前)	<1 Ω	<1 Ω	合格
接地电阻 (1.0 直径 SMT 后)	<1 Ω	<1 Ω	合格
耐焊性	288℃浸锡 10S 三次无分层起泡	未见起泡分层异常	合格
绝缘性能	>10 ⁸ Ω	>10 ⁸ Ω	合格
铅笔硬度	≧3H	3H 及 4H 铅笔测试均无划痕	合格
耐酸/碱性 (5%浓度常温浸泡)	浸泡 10 分钟, 无变色脱落现象	未见脱落变色异常	合格
耐酒精擦拭(固化后擦拭 10 次)	浸泡 10 分钟, 无变色脱落现象	未见脱落变色异常	合格
耐丁酮擦拭(固化后擦拭 10 次)	浸泡 10 分钟, 无变色脱落现象	未见脱落变色异常	合格
剥离强度	90°剥离时剥离强度 ≧7N	7.48N	合格
环保性	通过 ROHS,无卤及 REACH 检测	均送 SGS 检测中心检测	合格



◆ 产品操作使用步骤

1>开料：（生产操作温度 23℃以下，相对湿度 70%以下）

2>钻孔：（生产操作温度 23℃以下，相对湿度 70%以下）

3>冲切：（生产操作温度 23℃以下，相对湿度 70%以下）

4>对位贴膜：冷撕揭去透明保护膜，揭去面与 FPC 覆盖膜面相贴合于手工加热台上对位贴合贴紧。或用假贴机上膜 100℃，下膜 80℃对位贴合后假贴至少 10S。

5>快压（温度 175-185℃,预压 5-10 秒，成型 120 秒以上,压力 100-120kg/cm²）

6>固化(160-170℃,1-2 小时)

◆ 产品储存

密封存储于温度 2-10℃（冷库或冰柜），相对湿度 70%以下环境。（生产制造后，于上述环境中密封保存可保存 6 个月）

◆ 使用注意事项



- 1>请务必将冷藏保存的屏蔽膜温度回复至常温后再使用。避免结霜影响产品品质，到最后压合工艺至少需 6 小时以上。
- 2>开料后需管控存放时间，建议开料后 7 天内完成快压固化步骤。超期胶可能有老化问题。
- 3>如未贴合紧，传送中膜有可能松脱，导致快压步骤电磁膜受热收缩，产生偏位不良。
- 4>请在临时固定 1 小时内进行热压（此时请将屏蔽膜放在 $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 的环境中保管，避免高温老化）。
- 5>量产前请根据产品的外观，填充性，连接电阻来全面确认热压工艺（温度/压力/时间）。
- 6>采用增大接地直径，增加接地点，平面接地等扩大接触面的方法是强化接地效果最好的方法。
- 7>产品未固化前请避免于电磁膜表面丝印字符或压合 PI,避免与任何含溶剂或胶料的材质接触,以免侵蚀到电磁膜表面造成表观异常。
- 8>产品后烘固化后也要避免用强腐蚀性溶剂往复擦拭，以免腐蚀产品造成表观及性能异常。
- 9>固化后需于 2 小时内完成 SMT 打件，如超时请再次烘烤去湿然后打件，否则会造成 SMT 起泡异常。
- 10>使用电磁膜应设计避开无覆盖膜的 PTH/NPTH 孔，以免电磁膜压合于孔发生孔破不良。如不能避免此设计时，解决方案是：
用真空快压机降低压力（ $30\text{kgf}/\text{cm}^2$ 及以下）压合。
- 11>已开料部分超过一周未用完的，需要密封放入冷库存放。存储尽量不要超过一个月。